

**SEMICON<sup>®</sup>**  
*Japan 2009*

出展のご案内

[www.semiconjapan.org](http://www.semiconjapan.org)

009

INFINITE



POSSIBILITIES

SEMICON KOREA FPD CHINA SEMICON CHINA SEMICON SINGAPORE SEMICON RUSSIA SEMICON WEST PVJAPAN SEMICON TAIWAN SEMICON EUROPA SEMICON JAPAN

世界最大の半導体製造装置・材料の国際展示会

**セミコン・ジャパン 2009**

2009年12月2日(水)▶4日(金) 幕張メッセ

semi<sup>®</sup>

This is SEMICON Japan.



## セミコン・ジャパン 2009 に世界が注目!

- 第33回開催を迎えるセミコン・ジャパンは、  
今年大きな注目を集める展示会となります -

セミコン・ジャパンは、半導体ビジネスを未来へ導くキープレイヤーと技術が集結する、世界最大の半導体製造装置・材料の国際展示会です。世界同時不況に覆われた今こそ、業界の英知と技術をここに集結させ、「未来」に向かうグローバルビジネスコミュニケーションの場としての役割を發揮します。

SEMIは、1977年以來、半導体メーカーと装置・材料メーカーが一堂に会し、交流を深め、商談をすすめ、共通課題を議論する場としてセミコン・ジャパンを開催してまいりました。

半導体ビジネスは、常にここから動き始めます。最新・最先端の技術や製品が支える産業の活力と可能性を、今こそセミコン・ジャパンを通じて発信してください。

### 開催概要

名称: セミコン・ジャパン 2009 (SEMICON Japan 2009)

会期: 2009年12月2日(水)~4日(金) 10:00~17:00

会場: 幕張メッセ

主催: SEMI®

入場料: 無料 入場登録制

#### セミコン・ジャパン 2009 諮問委員会 (3月現在 敬称略 社名五十音順)

委員長	大日本スクリーン製造(株) 執行役員 半導体機器カンパニー副社長 兼 営業統轄部長	須原 忠浩
副委員長	(株)日本マイクロニクス 代表取締役社長	長谷川 正義
委員	(株)アドバンテスト 経営企画室 担当部長	平柳 緑
	アプライド マテリアルズ ジャパン(株) 技師長 工学博士	堀岡 啓治
	キャノンマーケティングジャパン(株) 専務取締役 産業機器カンパニー プレジデント	渋谷 博也
	(株)ディスコ 常務取締役 経営企画本部長	関家 圭三
	東京エレクトロン(株) シニア・フェロー	溝口 信
	(株)東京精密(ACCURETECH) 常務理事 C.T.O.	薦 清昭
	(株)ニコン 精機カンパニー 営業本部長	今 常嘉
	(株)日立ハイテクノロジーズ 半導体製造装置営業統括本部 事業戦略本部 本部長	塚本 康博
	横河電機(株) ATE事業部 システムLSIセンター マーケティング統括Gr. ライン長	大岡 浩一

#### セミコン・ジャパン 2009 運営委員会 (3月現在 敬称略 社名五十音順)

委員長	アジレント・テクノロジー・インターナショナル(株) 半導体パラメトリックテスト事業部マーケティング部ビジネス開発	渡辺 哲雄
副委員長	エスアイアイ・ナノテクノロジー(株) 管理部 営業企画課長	丸山 純夫
	レーザーテック(株) 企画IR室 アシスタント マネージャー	森下 礼子
委員	(株)アドバンテスト 営業本部 販売戦略統括部 販売推進部 Senior Engineer	千代村 裕三
	アプライド マテリアルズ コーポレートマーケティング部 Trade Show Manager	平澤 美香
	アプライシアテクノロジー(株) 営業部 II グループリーダー 兼 広報担当	松浦 江理子
	(株)アルバック 営業企画室 営業推進部	細工 英里子
	(株)在原製作所 精密・電子事業カンパニー 営業統括部 営業業務管理室 副参事	柴村 明紀
	(株)カシヨー 業務管理部 営業管理グループ	増田 優子
	キャノンアネルバ(株) お客様事業本部 お客様事業戦略推進部長	尾坂 高志
	キャノンマーケティングジャパン(株) 産業機器カンパニー 産業機器事業計画部 計画第二課 チーフ	荒井 幸司
	JSR(株) 広報部 主事	武田 佳子
	(株)新川 経営企画部 担当課長	吉田 智之
	スピードファム(株) 管理部 総務課 広報担当	平山 次男
	大日本スクリーン製造(株) 半導体機器カンパニー マーケティング部 担当課長	松永 聡
	(株)ディスコ IR・広報室 企画チームリーダー 兼 広報企画担当リーダー	村岡 弘嗣
	東京エレクトロン(株) 広報・IR室 主事補	野崎 貴弘
	(株)東京精密(ACCURETECH) 業務会社 広報・IR室 室長代理	貞方 勝廣
	(株)ニコン 精機カンパニー マーケティング部 商品企画課	北村 芳樹
	日本エム・ケー・エス(株) マーケティング・セールスサポート	會田 庸子
	(株)日本マイクロニクス 企画部 ビジネス企画推進室 担当課長	荒井 泉
	(株)日立ハイテクノロジーズ グループ戦略本部 戦略企画部 主任技師	大倉 宏



## 出展対象分野と製品

### ▶ 前工程 装置・部品関連ゾーン

- 設計工程・設計ツール  
半導体設計支援装置(回路設計・パターン設計)マスクレチクル用製造装置/その他関連装置
- ウェーハ製造工程  
単結晶製造装置/ウェーハ加工装置/ウェーハ検査評価装置/その他関連装置
- ウェーハプロセス工程  
露光・描写装置/レジスト処理装置/エッチング装置/ドライエッチング装置/熱処理装置/薄膜形成装置(CVD装置、スパッタリング装置、その他)/イオン注入装置/CMP装置/洗浄乾燥装置/ウェーハ検査評価装置

### ▶ 前工程 施設・材料関連ゾーン

- 装置用関連機器・環境関連  
各種搬送システム・装置/純水・薬液・水処理装置/各種ガス装置/クリーンルーム装置/光・レーザー発源/安全装置/その他関連装置
- 前工程装置用 材料関連  
基板ウェーハ/マスク用材料/プロセス装置用材料/その他薬品・気体

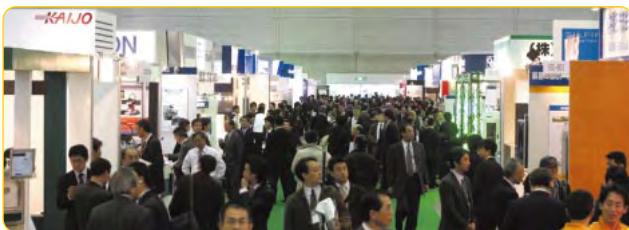


### ▶ 後工程 装置・部品関連ゾーン

- 組立工程  
ダイシング装置/ボンディング装置/パッケージング装置(搬送装置、測定装置、その他)封止装置/マーキング装置/はんだ付け装置/その他組立関連装置
- 試験・検査工程  
バーンイン装置/ロジックテスト装置/メモリ試験装置/リニアテストシステム/その他テストング・検査評価装置

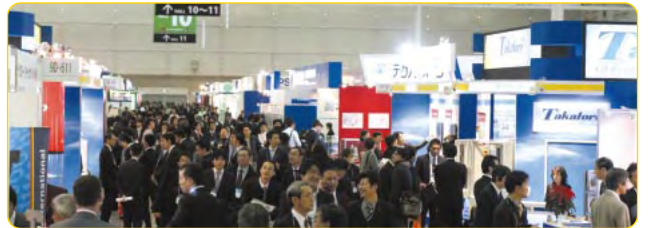
### ▶ 後工程 施設・材料関連ゾーン

- 組立・搬送装置用関連機器  
環境関連装置
- 後工程用 材料関連  
ハンダ/リードフレーム/モールディングコンパウンド/その他関連材料



### ▶ 総合ゾーン

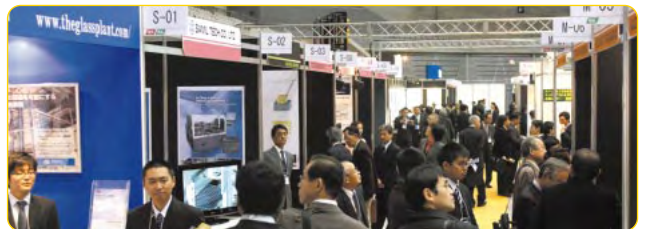
各種ソフトウェア(通信ソフトウェア、生産ソフトウェア、シミュレーションソフトウェア)その他前工程・後工程の両工程に関わる製品・サービス



### ▶ 特設パビリオン

これから注目される技術や業界の今後のトレンドに関する情報発信の場として、先端技術に関する5つのパビリオンを設置します。

- MEMSパビリオン**  
MEMS製造用装置/計測機器/材料/MEMSデバイス/MEMSアプリケーション/その他関連製品
- ナノテクノロジーパビリオン**  
ナノテクノロジー材料/ナノデバイス製造装置/計測測定装置/その他関連製品
- ベンチャーパビリオン**  
ベンチャー企業、知財・TLO関係の技術/MEMS・ナノテクノロジーにこだわらないエレクトロニクス関連の新技術
- 製造エンジニアリングパビリオン**  
MES/APC/CIM/EES/FDC/各種生産システム技術/プラットフォーム/アプリケーション/その他関連情報
- 有機半導体パビリオン**  
有機半導体材料/有機半導体製造装置/有機半導体に関わるアプリケーション関連



INFINITE



EXHIBIT NOW

POSSIBILITIES

## セミコン・ジャパン会場 幕張メッセ

幕張メッセは、170,000m<sup>2</sup>を超える敷地に、国際展示場、国際会議場、イベントホールで構成される日本最大級の本格的コンベンション施設です。展示場は、約75,000m<sup>2</sup>の規模を誇り、大空間を生かした画期的ディスプレイが可能です。

- セミコン・ジャパン展示会場：国際展示場
- SEMIテクノロジーシンポジウム：国際会議場内コンベンションホール、会議室
- SEMIスタンダード会議：国際会議場内会議室

所在地：〒261-0013 千葉市美浜区中瀬2-1 [www.m-messe.co.jp](http://www.m-messe.co.jp)



## 前年度(セミコン・ジャパン 2008)実績

- ▶ 出展社・出展小間数 1,477社(共同出展社含む) 4,450小間  
(2007年実績 1,548社 4,602小間 22カ国・地域)
- ▶ 国・地域別出展社数(22カ国・地域)

日本	1,154	イギリス	7	スウェーデン	2
アメリカ	153	カナダ	5	ロシア	2
韓国	43	スイス	5	アイルランド	1
ドイツ	42	中国	5	インド	1
イスラエル	12	オーストリア	4	ハンガリー	1
フランス	12	マレーシア	3	ベルギー	1
台湾	12	イタリア	2		
シンガポール	8	オランダ	2		

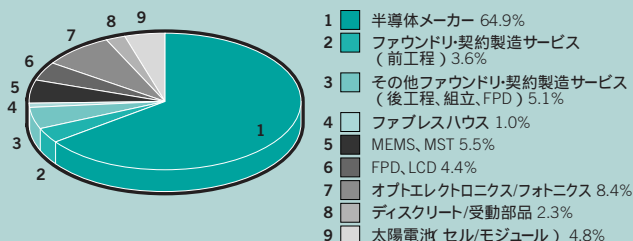
- ▶ 日別来場者数(出展者数を含む概算人数)

日付	延べ人数(内は2007実績)
12月3日(水)	約31,500(約34,600)
12月4日(木)	約32,700(約38,300)
12月5日(金)	約32,800(約37,100)
合計	約97,000(約110,000)

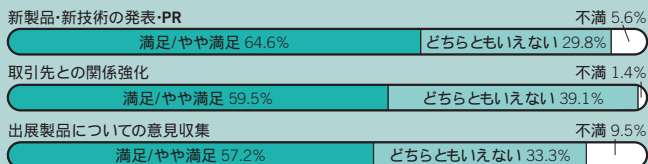
- ▶ 実来場者数(同人物の重複カウントなし)

内訳	人数(内は2007実績)
展示会場	51,387(60,508)
セミナー受講者	2,438(2,684)

- ▶ デバイスメーカー来場者\*の業種内訳 \*全来場者の25.4%



- ▶ 出展社満足度調査結果



- ▶ 出展社の声

『これまでの出展経験から優良な来場者が多いので出展を継続しています。今回の出展では展示機をすべて動作モデルとしたこともあり、新規取引先の開拓という目的において効果を感じています。一方、既存製品のPRも行ったので、既存ユーザーとの関係強化にも効果がありました。』

『今回は、新製品の発表を目的として出展したので、ブースレイアウトを工夫して目玉商品を目立つようにしました。新製品を動かして、デモンストレーションも行いました。満足な結果となっています。』

『業界唯一の展示会なので、自社のPR・知名度向上のために出展しました。二度目の出展となった今回は、ブースレイアウトを工夫し、来場者の受け入れ体制を整えることができました。事前のPRと会場でのPR双方に力を入れたので、出展目的を達成できたと感じています。』

『新製品の発表の場としてふさわしいと思い、新規取引先の開拓を目的に出展しました。通路側には人目を引くものをディスプレイし、全説明員がすべてをカバーできるような体制で臨みました。管理職の方から、研究者、購買の方々にもブースでお会いすることができ満足しているので、次回も出展を予定しています。』

## 出展要項

### 1. 出展小間料金

- ▶ 基本小間サイズ: 1小間9m<sup>2</sup>
  - ▶ 出展小間料金: SEMI会員 336,000円(税込)/一般 441,000円(税込)
    - SEMI会員およびSEMI会員企業の子会社で登録済の企業向け通常価格: 336,000円(税込)
    - 非会員価格: 441,000円(税込)
- 小間数は1小間を単位として制限を設けません。  
すべてスペース渡しになります。(社名板、床カーペット、間仕切りパネルは含まれません。)  
SEMI会員に関しては申込時期にかかわらず、1小間出展の場合は31,500円、2小間以上出展の場合は合計金額から47,250円の割引が適用されます。

通常小間料金(税込)

	SEMI会員*	非会員
1小間出展の場合	¥304,500	¥441,000
2小間出展の場合	¥624,750	¥882,000
3小間出展の場合	¥960,750	¥1,323,000
4小間以降	¥336,000/小間	¥441,000/小間

\*割引適用後の料金です。

- ▶ 特設パビリオン小間料金

- 基本小間サイズ: 1小間2m<sup>2</sup>/4m<sup>2</sup>/9m<sup>2</sup>の3種類

特別パビリオン小間料金(税込)

	SEMI会員	非会員
幅2m×奥行1m小間(基礎装飾込) (同一パビリオン内1社1小間限定になります。)	¥136,500	¥157,500
幅2m×奥行2m小間 (スペースのみ)	1小間料金	¥168,000
	2小間料金	¥346,500
	3小間目以降	¥178,500/小間
幅3m×奥行3m小間(スペースのみ)	通常小間料金と同額	

### 2. 小間形態(以下、図はイメージです)

- ▶ 一列小間

1小間~8小間まで



- ▶ 並列小間

4小間、6小間、8小間  
10小間、12小間、16小間



- ▶ ブロック小間

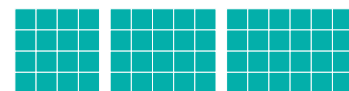
• 2列小間形態  
4小間、6小間、8小間  
10小間、12小間、16小間



• 3列小間形態  
9小間、12小間、15小間  
18小間、21小間、24小間



• 4列小間形態  
16小間、20小間、28小間、  
32小間



24小間未満の出展小間形態に関しては、1辺から2辺が他社と接する場合があります。

- ▶ 独立小間(32小間以上)

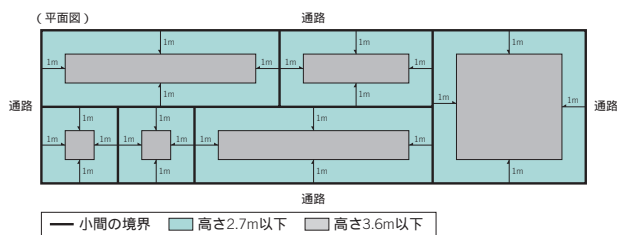
形態については事務局までお問合せください。

## 3. 小間の規格・仕様

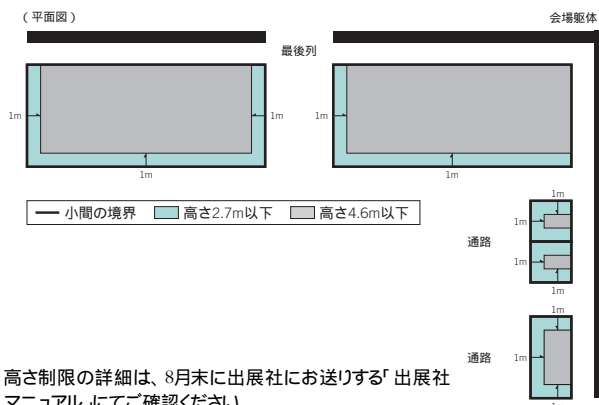
### ▶ 通常小間

- 1) 規格: 間口 3m × 奥行 3m
- 2) 仕様: スペース渡し(他社と隣接する面の間仕切りパネルは設置しません)
- 3) 高さ制限: 装飾物の高さ規定は基本2.7mとなりますが、以下の例外を認めています。

出展小間位置が会場躯体に面していない場合:  
小間の境界線から小間内1mより高さ3.6mまでとします。



出展小間位置が会場躯体に面する場合:  
小間の境界線から小間内1mより高さ4.5mまでとします。



### ▶ 特設パビリオン小間

#### 1) 各サイズの規格と仕様

規格: 間口1.98m × 奥行0.99m × 高さ2.7m  
仕様: 基礎壁面 / 展示台(幅 0.99m × 奥行0.495m × 高さ0.8m) / 社名サイン / スポットライト / コンセント(100V 500wまで) / 電気幹線工事費(100V 500wまで) / 電気使用料(100V 500wまで)

規格: 間口1.98m × 奥行1.98m × 高さ2.7m  
仕様: 背面となる面の間仕切りパネルおよび他社と隣接する面の間仕切りパネルをシステムパネルで設置します。なお、角小間の通路側の間仕切りパネルは設置しません。

規格: 間口2.97m × 奥行2.97m × 高さ2.7m  
仕様: 背面となる面の間仕切りパネルおよび他社と隣接する面の間仕切りパネルをシステムパネルで設置します。なお、角小間の通路側の間仕切りパネルは設置しません。

2) 高さ制限: 装飾物の高さ規定はすべて2.7mとなります。

## 4. 申込方法

貴社の出展製品・サービスに応じて、出展ゾーンをお選びいただき、別添の展示小間申込書・契約書に必要事項をご記入、捺印の上、SEMIジャパン展示会部までご送付ください。

## 5. 申込先

SEMIジャパン 展示会部  
〒102-0074 東京都千代田区九段南4-7-15  
TEL: 03.3222.6022 FAX: 03.3222.5757

## 6. 申込期日

- 締切: 2009年6月25日(木)
- お申込みの際は、別添の申込書・契約書の裏面にある展示会規約を必ずお読みください。

## 7. 出展料金の支払い

出展小間料金はSEMIジャパンからの請求により、以下の期限までに指定の銀行口座にお振込みください(指定口座は請求書に記載)。振込手数料は出展社の負担とします。なお、手形によるお支払いはお受けできません。

- 振込締切: 2009年7月24日(金)

## 8. 出展小間料金に含まれるもの

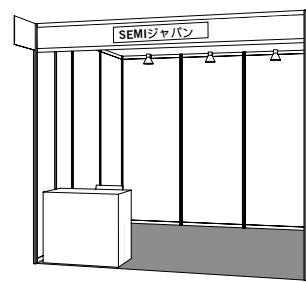
- 出展社バッジ、作業員バッジ
- 小間数に応じた展示会案内状、展示会ポスター
- 公式Webサイト出展社名掲載スペース(和・英)
- 公式Webサイト内「ブースナビゲーター」出展社紹介掲載スペース

## 9. 出展小間料金に含まれないもの(料金は税込)

- 各種クーティリティー使用料:  
電気工事費 単相100V/単・三相200V共 7,350円/1kw  
電気使用料 1,995円/1kw
- 仕切りパネル(特設パビリオン出展を除く)
- 自社出展機器などに付保した損害保険料
- 前記無料枚数を超える展示会案内状
- 展示会案内状送付用封筒
- 展示・実演および搬入作業中に発生した対人傷害などの事故にかかる費用
- 法令および展示規則に基づく展示装飾等の改修費用

## 10. 各種工事・その他経費(料金は税込)

- 1) 圧縮空気・給排水工事
  - 圧縮空気工事費 81,900円/1箇所
  - 給排水工事 76,650円/1箇所
  - 水道使用料 813円/1m<sup>3</sup>
- 2) 残業代  
搬入期間中および会期中の規定作業時間外に作業を行う場合、残業代をご負担いただきます。
  - 残業代 52,500円/時間
- 3) 出展社専用ストックルーム
  - 規格: 間口3m × 奥行2m × 高2.1m
  - 料金: 105,000円/1棟
- 4) パッケージブース
  - 基本仕様: 社名板 / システム基礎パネル / バックパネル、サイドパネル / カーペット / 受付用カウンタ / イス(2脚) / 蛍光灯 / コンセント / 電気幹線工事・使用料
  - 料金: パッケージブース1小間: 136,500円 / パッケージブース2小間: 273,000円  
パッケージブースはいくつかのバリエーションを用意しております。詳細は「出展社マニュアル」でご案内します



## 11. 出展小間数の変更と出展の取消し

別添の申込書・契約書裏面にある展示会規約VIIをお読みください。

## 12. 小間位置の決定

出展社説明会開催日(9/2水 東京、9/3木 大阪)にて小間位置を発表します。小間位置は、原則としてSEMI会員の有無、過去の出展実績展示物の分類、プライオリティーポイント等を考慮の上、事務局にて決定します。

## 13. 外国製品出展品(装飾物含む)の持込みについて

本展は、展示会場全ホールを保稅展示場申請いたします。保稅展示場と承認されますと、日本以外で生産、製造されたもので、まだ輸入通関手続きを済ませていないものを、輸入通関することなく外国貨物のまま出展することができます。

## セミコン・ジャパンの特色

### 世界最大の半導体製造装置・材料の総合展示会

— 半導体製造装置・材料に関わるすべての製品・技術・サービスを網羅した総合展示会 —

国内外約1,500社、4,450小間(昨年実績)が、幕張メッセを使用して最新情報を発信する世界最大の展示会です。関連業界の多種多様な企業の出展による相乗効果が付加価値を生み、高い出展効果を得られます。

### 新製品・新技術発表に最適な展示会

— 来場目的のトップは、「新製品・新技術を見る」 —

来場者の8割近くが、新製品・新技術を見ることを主な目的としています。最新の技術や事例を取り上げる「技術セミナー」や「技術シンポジウム」を展示会と同時開催することでシナジー効果を計り、目的意識の高い来場者を多く誘致し、新技術や業界動向の広範囲な情報発信の場として数多くのビジネスマッチングが図れます。

### 新チャンネル/ビジネス拡大に最適な展示会

— 多様な業種・業態の来場者に潜在する新しいニーズとチャンネルの獲得 —

来場者の約7割は製品の購入や導入に関係されています。半導体のみならず、太陽光発電、MEMS、ナノテクノロジー、有機半導体など、今後のトレンドの情報発信の場としてもセミコン・ジャパンは活用されています。レセプションや出展社によるセミナーなどビジネス拡大のためのコミュニケーションの場を利用して、課題解決の糸口を求めている潜在的な顧客の獲得が期待できます。

### 自社PR、技術PRに最適な展示会等

— 国内の関連業界に認知度・知名度・信頼度を向上させる絶好の機会 —

半導体製造装置関連の総合展示会としては、国内唯一、世界最大の展示会です。国内外の報道関係者からも注目される中、SEMIのネットワークを利用して、自社だけでは困難な業界へのPRを可能とし、展示会終了後もグローバルに情報発信を行えます。幅広い製品・技術を「実際に見る、説明を聴く」といった直接的なコミュニケーションの場にとどまらず、真にグローバルな「質の高い」展示会を実感できます。

## 出展社サポートツール

### ▶ セミコン・ジャパン2009 公式Webサイト

#### www.semiconjapan.org

128万ページビューを超えるセミコン・ジャパン公式Webサイトを通じて、開催前からさまざまな展示会情報をいち早く情報発信します。

### ▶ ブースナビゲーター(出展社検索システム) 無料

来場者、報道関係者が事前情報収集に最も活用するツールです。事前情報発信にお役立ていただけます。予め登録していただいた出展製品の見どころ、技術製品情報を10月より掲載します。



### ▶ 新製品・新技術紹介ギャラリー 無料

公式Webサイト上に新製品・新技術ギャラリーを設けます。各社の新製品・新技術の紹介にご活用いただけます。



### ▶ 案内パンフレット 無料

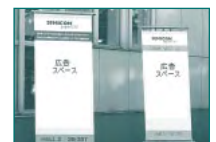
展示会情報を記載したパンフレットを、出展小間数に応じた規定枚数分お送りします(和・英文)。また、中国語、韓国語といったアジア地域言語でのパンフレットもWeb上に用意しております。

### ▶ ブースナビゲーター バナー広告 有料

126万ページビューを持つブースナビゲーターに出展企業のバナー広告スペースを用意しております。来場ターゲットへの事前告知ツールとしてご活用いただけます。

### ▶ 会場サイン広告 有料

会場内外に設置する各種案内サイン看板に社名を掲載いただけます。自社ブースへの誘導に有効です。



### ▶ フロアガイド広告 有料

来場者に当日無料配布するフロアガイドに広告を掲載いただけます。来場者が持ち歩くガイドへの広告掲載は、集客に効果的です。



## セミコン・ジャパン 2009 開催までのスケジュール

6月 6月25日(木) 申込締切

7月 7月24日(金) 出展料金振込締切

8月 8月下旬 出展社マニュアル送付

9月 9月2日(水) 出展社説明会(東京)

9月3日(木) 出展社説明会(大阪)

9月4日(金) 出展社専用マイページオープン

10月 10月初旬 各種書類締切(搬入・搬出計画・展示装飾・電気工事・宿泊などに関する提出書類)

10月中旬 ブースナビゲーター オープン  
来場者用案内状送付

11月 11月初旬 各種作業証送付(車輛証・出展社バッチ・作業員証)  
11月29日(日)~12月1日(火) 搬入

12月 12月2日(水)~4日(金) 会期

## 情報の発信とプロモーション

SEMIでは、幅広いメディアを通じたセミコン・ジャパンの広報活動と、来場者誘致のためのプロモーション活動を計画しております。以下昨年実績に準じたプロモーションを行う予定です。

### セミコン・ジャパン 2008 報道実績

朝日新聞、日本経済新聞などの全国紙をはじめとする活字メディアや電子メディアに、専門展示会としては異例ともいえる多数の記事が掲載され、業界内のみならず、関連産業や投資業界などから広く注目を集めています。また、NHK、テレビ東京などキー局をはじめ、多くの番組で報道されました。

- ▶ テレビ キー局放送実績
  - NHK おはよう日本 • NHK 経済最前線 • テレビ東京 NEWS FINE
- ▶ 国内メディア掲載記事数(2009年1月30日集計)
  - 開催前 138 • 会期中 159 • 開催後 74 • Web 256 合計 627
- ▶ プレス発表
  - 2008年
  - 3月24日 第15回 STS Award 受賞者発表
  - 4月14日 「セミコン・ジャパン 2008」出展申込みの受付について
  - 4月21日 STS 2008 講演論文募集のお知らせ
  - 10月1日 「セミコン・ジャパン 2008」開催について
  - 10月1日 「SEMIテクノロジーシンポジウム(STS) 2008」開催概要
  - 10月7日 学生向け企画「セミコンへ行こう!」実施について
  - 11月11日 セミコン・ジャパン 2008 開会式について
  - 11月17日 SEMIの日本地区におけるスタンダード各賞 受賞者発表
  - 12月2日 「セミコン・ジャパン 2008」明日より開催
  - 12月2日 記者会見
  - 12月2日 SEMI、半導体製造装置の2008年末市場予測を発表
  - 12月2日 2008年井上皓EHS賞 受賞者発表
  - 12月3日～5日 プレスルーム開設
  - 12月17日 「セミコン・ジャパン 2008」開催報告

### セミコン・ジャパン 2008 広告実績

- ▶ 新聞広告実績
  - 化学工業日報、電波新聞、日刊工業新聞、半導体産業新聞
- ▶ 雑誌広告実績
  - Electronic Journal、IEN、Industrial Laser Solution Japan、Laser Focus World Japan、M&E、Semiconductor FPD World、Semi-conductor International日本版、映像インダストリアル、エレクトロニクス実装技術、月刊オプトロニクス、月刊トライボロジー、機械設計、クリーンテクノロジー、工業材料、電子材料、日工フォーラム、日経エレクトロニクス
- ▶ オンライン広告( Webサイト・Email )実績
  - EE Times Asia、Electronic Journal Webサイト、G-マガ、Semiconductor Japan Net、Tech-On!、Tech-On! China、Tech-On! English、イブロス、製品ナビ、光産業e-mailニュース、日経エレクトロニクスNEWS、日経マイクロデバイスNEWS、日経ものづくりNEWS

### 質の高い来場者を誘致するプロモーション計画

展示会案内パンフレットのダイレクトメール  
SEMIが保有するデータベースを活用し、昨年の来場者を中心に約7万件のターゲットに送付します。

新聞/雑誌/オンライン広告  
各種媒体の特徴を活かした広告を展開し、来場者の誘致を働きかけます。また、開催に合わせた媒体による特集記事の掲載も行われます。

公式Webサイトからの最新情報の発信  
セミコン・ジャパン 2009 公式Webサイトより、来場者に最新の情報を分かりやすく提供します。ブースナビゲーター(出展社名・出展製品検索システム)をWebサイトから提供し、来場者へ事前に出展社情報を提供します。

Emailによるプロモーション  
ダイレクトメール送付先ならびに事前登録者に対し、最新情報をEmailで継続的に配信します。Emailによる配信情報は公式Webサイトと連動し、出展社情報の収集、出展社セミナー等のイベントへの参加を促します。

ポスターの配布  
ポスターは、出展社に配布して掲示いただくほか、後援・協賛団体などの協力機関や全国200以上の自治体に配布します。

報道機関への働きかけ  
会期終了までの間、適時ニュースリリースを発行し、メディアへの露出と展示会取材の増加を推し進めます。

機関誌、メールマガジンによる案内  
SEMIの機関紙で開催情報を会員へ提供するほか、約10万人に配信するSEMIのメールマガジン「SEMI通信」でも複数回の特集を組みます。

SEMIの海外オフィスの活用  
SEMIが世界の主要拠点12都市に置くオフィスを通じて、担当地域の顧客へ来場を呼びかけるほか、各地のSEMICONショーでもプロモーションを行います。

重要顧客への個別訪問  
国内外の重要顧客を訪問し、セミコン・ジャパン 2009への来場を呼びかけます。

## SEMI会員制度のご案内

SEMIは、半導体をはじめとするマイクロエレクトロニクス・FPD(フラットパネルディスプレイ)・太陽光発電産業の製造サプライチェーンをサポートする国際的な工業会です。

すでに40年の長きにわたって活動を続けており、約2,100社の会員企業を擁し、この内日本企業は640社にのぼります。世界12都市にオフィスを構え、これらオフィスの緊密なネットワークを通じ、「技術」と「ビジネス」の両面から、会員企業とそのユーザーの共通課題の解決を支援し、業界の発展に寄与しています。

SEMIにご入会いただきますと、展示会出展料金の割引などの特典が得られます。この機会にSEMIへのご入会をご検討ください。

### SEMI主催展示会における会員の特典

- 展示会出展料金の会員割引
- SEMIが主催する展示会の出展の優先権
- 小間位置の優先権(プライオリティポイントの付与)

年会費(税込)

半導体・FPD年間売上高	正会員	準会員	賛助会員	関連会員
0～6億円未満	¥231,000	¥115,500		¥86,625
6億円以上～30億円未満	¥404,250	¥173,250		¥115,500
30億円以上～120億円未満	¥1,155,000	¥519,750		¥288,750
120億円以上～600億円未満	¥2,310,000	¥750,750	¥57,750	¥404,250
600億円以上～1,200億円未満	¥3,465,000	¥1,039,500		¥577,500
1,200億円以上～3,000億円未満	¥5,197,500			
3,000億円以上	¥6,930,000	¥1,617,000		¥866,250

価格は消費税を含みます。

# セミコン・ジャパン 2009 セミナーとイベント

- 各分野第一線の技術者が集結し、最先端/最新技術を発信 -

セミコン・ジャパンは、半導体の装置・材料業界をグローバルにリードする展示会であると同時に、さまざまなセミナーや会議の開催を通じて、有益な情報を提供する総合イベントです。セミコン・ジャパンが提供するセミナーとイベントは、技術情報の世界への発信とグローバルな情報交流の機会を支えています。

## セミナー関連

### ▶ オープニングキーノート

セミコン・ジャパンのオープニングを飾る基調講演セッションです。業界トレンドを共有し、セミコン・ジャパンとしてのメッセージを発信する場として、今年も国内外半導体業界のトップエグゼクティブの出演を予定しています。



### ▶ SEMIテクノロジーシンポジウム(STS)

半導体技術動向、技術課題、その実用化技術について、第一線の技術者の方々より語られるSEMI最大のシンポジウムです。講師陣、講演内容ともにその質の高さにおいて業界から大きな評価をいただいております。27回目を迎えた昨年は、3日間で全10セッション、92講演が行われました。今年も、ホットなテーマが盛りだくさんのプログラムを予定しています。

昨年行われたセッションは次のとおりです。

- 次世代エネルギーデバイス
- 検査/メトロロジー
- エッチング
- 多層配線
- DFM/マスク
- 先端デバイス
- リソグラフィ
- パッケージング
- テスト
- マイクロシステム/MEMS
- STS Award受賞記念講演



### 講演論文募集

STSプログラム委員会では、STSでの講演論文を公募しています。結果は7月末に応募者宛てに順次通知します。詳細はWebサイト(<http://www.semiconjapan.org>)をご確認ください。

### ▶ テクニカルビジネスプログラム

業界の市場動向を探るセミナーや各技術分野のワークショップ、トレンドトピックであるEHS、太陽光発電や中古半導体なども採り上げ、幅広いニーズに応える多彩なプログラムです。昨年は次の11プログラムが開催されました。

- Next Generation Factory e-Manufacturing ワークショップ
- 世界半導体フォーラム
- 国際EHS規制適合セミナー
- SEMIマーケットセミナー
- IPSS( International Packaging Strategy Symposium )
- 第9回地球環境シンポジウム
- JEITA / Selete EES ワークショップ
- 中古半導体製造装置セミナー
- 量産立上げに寄与するトレーサビリティ
- 第3回SEMI太陽光発電技術シンポジウム
- DFMプロダクトマネジメント ワークショップ

### ▶ SEMIスタンダード関連プログラム

大別して、SEMIスタンダードの解説を目的としたSTEP( Standards Technical Educational Program )と、技術標準の方向性を探ることを目的としたワークショップの2種類があります。昨年は次の9プログラムが開催されました。

- STEP/S2-0706
- 半導体製造設備におけるEMC対策の最新動向
- シラン系ガス取り扱い安全ガイドラインワークショップ
- 半導体製造装置における静電気問題と対策
- モジュール技術と標準化
- NGR( Next Generation Factory )ワークショップ
- FAB生産性向上のための待ち時間分析
- STEP/P44 OASIS.MASK/P45 MALY
- 次世代ウェーハ ワークショップ

## イベント関連

### ▶ SEMIプレジデントレセプション

グローバルビジネスである半導体産業を象徴するVIPレセプションです。例年400名を超える業界エグゼクティブの方々にご参加いただいております。



### ▶ SEMIスタンダード フレンドシップパーティー

日ごろSEMIスタンダード活動に尽力いただいている委員の方々のレセプションです。貢献の著しかった方々を称えるSEMIスタンダード各賞の授賞式も同時に執り行われます。昨年は、SEMI国際スタンダード活動35周年の記念すべきイベントとなりました。



**SEMICON<sup>®</sup>**  
Japan2009



お問合せは

SEMI ジャパン 展示会部  
〒102-0074 東京都千代田区九段南4-7-15  
Tel: 03.3222.6022 Fax: 03.3222.5757  
Email: [jshowsinfo@semi.org](mailto:jshowsinfo@semi.org)  
[www.semi.org](http://www.semi.org)

SEMI® GLOBAL EXPOSITIONS



©2009 SEMIジャパン

